finetech

FINEPLACER® core^plus

ホットエアー SMDリワークステーション

多目的なソリューション

- 独自のFINEPLACER® シリーズの原理
- ホットエアー対応リワーク装置

業界トップクラスの熱処理方法を提供

実行中プロセスの観察

データ及びメディアでの記録機能とレポート管理機能

タッチスクリーン操作による全てのプロセスへのアクセスと容易な視覚的プログラミング

定義済みパラメータによるシーケンス制御

特長	利点
10μm以内の搭載精度	高密度実装PCBまたは高精度が求められるアプリケーションに対するリワーク
汎用性の高い装置構成	SMT製造の多くのプロセスステップを組み合わせる事が出来、OEM品質でのリワークを実現
顧客毎のツール作成	汎用性のあるものから、個別対応のツールを作成する事が可能、制限の無いリワーク性能を提供
固定式ビームスプリッターによるオーバーレイビジョンアライメントシステム(VAS)	チップと基板の高精度ビジュアルアライメント
3色LED照明	異なる素材に対する優れたコントラスト / 優れた可視性と画像認識による
全プロセスへのアクセスと容易なプログラミング	プロセスシーケンスの高速構築と、直感的なプロセス実装
パラメータに関連付いた全てのプロセスの同期制御	最大限のプロセス管理と再現性
トップヒーターはソフトウェア制御校正機能有り	確実なリフロープロファイルによる高い生産性を実現します。プロファイルは装置間で共有化され、プロセスの結果を保証します。
モジュールシステムの採用により、装置導入後に各種モジュールの追加が可能	新しいアプリケーションと技術の要求に即時に簡易に適合します。
プロセスモジュールによる個別構成	アプリケーション要件に合わせたオーダーメイドのソリューション
フルオート、及びセミオート機種の対応	お客様のアプリケーション要求に応じたリワーク装置を提供。
微細な荷重制御による部品の取り扱い	微小デバイス、繊細なデバイスを安全にハンドリング(008004等)

実装方式

» 表面実装技術（SMT)
» スルーホール技術（THT)
» ピン in ペースト（PiP）

対応プロセス

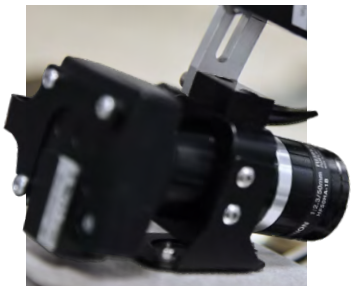
» コンポーネントリムーブ/デソルダリング
» 非接触サイトクリーニング / ソルダーリムーブ
» リボール/ シングルボールリボール
» ペーストプリント　(コンポーネント、PCB)
» ディッピング
» ディスペンディング
» ソルダリング

アプリケーション

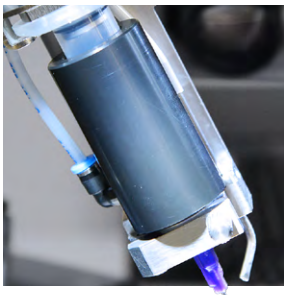
» BGA, CSP, QFN, DFN, QFP, PGA, SOT など
» 微小BGA、微小チップ
» 小型パッシブコンポーネント (008004まで)
» LED、Mini LEDアレー
» パッケージ　on パッケージ (PoP)
» ドーターボード、サブ基板
» RF シールド、RF フレーム
» コネクターソケット
» アンダーフィル、コーティングコンポーネント
» FR4リワークフレックス基板、グラス、セラミクス、アルミキャリア

モジュール及びオプション

- » バーコードリーダー(SmartIdent)
- » コンポーネント供給
- » ダイレクトコンポーネントプリントモジュール
- » ディスペンサーモジュール
- » ホットガス ボトムヒーティングモジュール
- » デッピング/スタンピングモジュール
- » PCBサポート
- » プロセスガス切替モジュール
- » プロセススタートセンサー
- » プロセスビデオモジュール
- » リボールモジュール
- » RGW - Illumination
- » ハンダ除去モジュール
- » 分割視野光学系
- » 基板サポート
- » ターゲットファインダー
- » 上側加熱モジュール(加熱ガス)
- » タッチスクリーン(スマートコントロール)

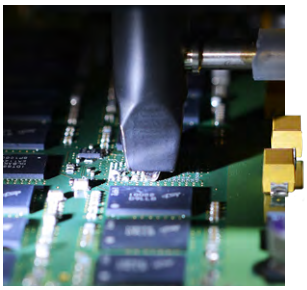


プロセスビデオモジュール

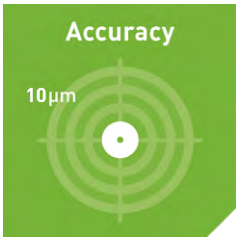


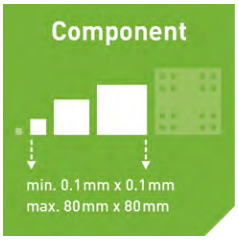
ディスペンサーモジュール

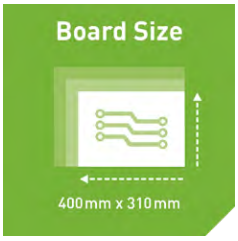
プロセススタートセンサー



ハンダ除去モジュール

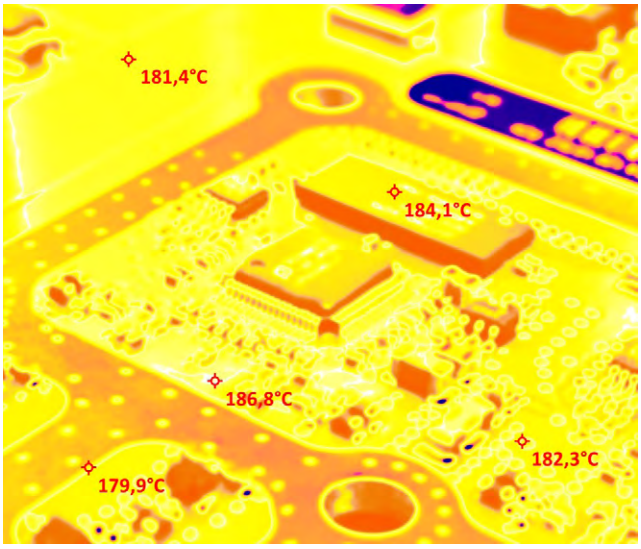


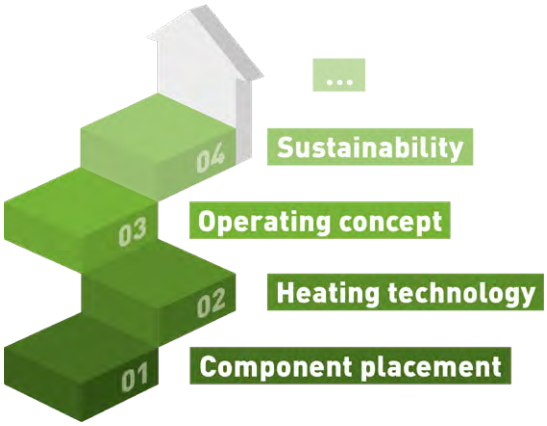




ホットガステクノロジー

ホットガス（対流式加熱）では、部品単体やアセンブリの色や表面仕上げにかかわらず、それらは均一に加熱されます。また、空気の流れをはんだ付け箇所に正確に導くことができるため、必要な箇所にのみ熱エネルギーを加えることができます。これは、装置と対象アセンブリの間のインターフェースとして機能する、各コンポーネント専用のはんだ付けツールを使用することで実現されます。この機能は、市場に出回っているほとんどのSMDコンポーネントを処理できると同時に、その周囲のコンポーネントを過熱から保護します。非常に急峻な加熱・冷却を行うことができるため、サイクルタイムの短縮とスループットの向上が可能です。もう一つの利点は、窒素を加え、不活性雰囲気中でハンダ付けすることで、酸化を防ぎ、より良い濡れ性を確保できることです。





どのリワークシステムが要件に適するか

OEM企業やEMSサービスプロバイダーの生産管理者やプロジェクト管理者の方はプロフェッショナルなSMDリワークシステムの選択に直面しているのではないでしょうか？ニーズに合ったソリューションを見つけるためにはまず確認すべきいくつかの質問があります。市場に出回っているどのタイプのリワークシステムが、自社の生産やプロジェクトの要件に最適なのか、事前に評価しておく必要があります。このチェックリストは、さまざまな業界でリワークを行われているお客様と共同で作成されたもので、将来のシステムを選択するために考慮すべき事項をまとめたものです。

資料のダウンロードはこちら：

カスタマーフィードバック

"The trend towards ever increasing data rates demands large bandwidths and thus usage of higher and higher frequencies. ICs are getting smaller and BGA-packages more common in an RF-Engineer's day to day work. The FINEPLACER® core gives us the means to handle those ICs reliably, saving us time and nerves. It is a great extension of our assembly technology."

Prof. Dr.-Ing. habil. Alexander Kölpin
Head of Institute for High Frequency Technology, Hamburg University of Technology

Technical information and specifications are subject to change without prior notice
© Finetech GmbH & Co. KG